



中华人民共和国国家标准

GB/T 10191—2011/IEC 60384-16-1:2005
代替 GB/T 10191—1988

电子设备用固定电容器 第 16-1 部分：空白详细规范 金属化聚丙烯 烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ

Fixed capacitors for use in electronic equipment—
Part 16-1: Blank detail specification:
Fixed metallized polypropylene film dielectric
d. c. capacitors
Assessment levels E and EZ

(IEC 60384-16-1:2005, IDT)

2011-12-30 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

《电子设备用固定电容器》系列国家标准分为如下若干部分：

- 第 1 部分：总规范(GB/T 2693—2001/IEC 60384-1:1999)；
- 第 2 部分：分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 7332—2011/IEC 60384-2:2005)；
- 第 2-1 部分：空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(IEC 60384-2-1:2005)；
- 第 3 部分：分规范 表面安装 MnO₂ 固体电解质钽固定电容器(IEC 60384-3:2007)；
- 第 3-1 部分：空白详细规范 表面安装 MnO₂ 固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-3-1:2007)；
- 第 4 部分：分规范 固体和非固体电解质铝电解电容器(GB/T 5993—2003/IEC 60384-4:1998,第 1 号修改单:2000)；
- 第 4-1 部分：空白详细规范 非固体电解质铝电解电容器 评定水平 EZ(GB/T 5994—2003/IEC 60384-4:2000)；
- 第 4-2 部分：空白详细规范 固体(MnO₂)电解质的铝电解固定电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-4-2:2007)；
- 第 6 部分：分规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器(IEC 60384-6:2005)；
- 第 6-1 部分：空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器(IEC 60384-6-1:2005)；
- 第 7 部分：分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10185)；
- 第 7-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(GB/T 10186)；
- 第 8 部分：分规范 1 类瓷介固定电容器(GB/T 5966—2011/IEC 60384-8:2005)；
- 第 8-1 部分：空白详细规范 1 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5967—2011/IEC 60384-8-1:2005)；
- 第 9 部分：分规范 2 类瓷介固定电容器(GB/T 5968—2011/IEC 60384-9:2005)；
- 第 9-1 部分：空白详细规范 2 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-9-1:2005)；
- 第 11 部分：分规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-11:2008)；
- 第 11-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-11-1:2008)；
- 第 12 部分：分规范 金属箔式聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-12:1988)；
- 第 12-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(IEC 60384-12-1:1988)；
- 第 13 部分：分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-13:2006)；
- 第 13-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(IEC 60384-13-1:2006)；
- 第 14 部分：分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器(GB/T 14472—1998/IEC 60384-14:1993,第 1 号修改单:1995)；
- 第 14-1 部分：空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平 D(GB/T 14473—

- 1998/IEC 60384-14-1:1993);
- 第 15 部分:分规范 非固体或固体电解质钽电容器(GB/T 7213—2003/IEC 60384-15:1982, 第 1 号修改单:1987,第 2 号修改单:1992);
 - 第 15-1 部分:空白详细规范 固体电解质箔电极钽电容器 评定水平 E(可供认证用)(GB/T 12794—1991/IEC 60384-15-1:1984);
 - 第 15-2 部分:空白详细规范 固体电解质多孔阳极钽电容器 评定水平 E(可供认证用)(GB/T 12795—1991/IEC 60384-15-2:1984);
 - 第 15-3 部分:空白详细规范 固体电解质和多孔阳极钽电容器 评定水平 E(GB/T 7214—2003/IEC 60384-15-3:1992);
 - 第 16 部分:分规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器(IEC 60384-16:2005);
 - 第 16-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 10191—2011/IEC 60384-16-1:2005);
 - 第 17 部分:分规范 金属化聚丙烯薄膜介质交流和脉冲固定电容器(IEC 60384-17:2005);
 - 第 17-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-17-1:2005);
 - 第 18 部分:分规范 固体(MnO₂)和非固体电解质片式铝固定电容器(GB/T 17206—1998/IEC 60384-18:1993,第 1 号修改单:1998);
 - 第 18-1 部分:空白详细规范 表面安装固体(MnO₂)电解质铝固定电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-18-1:2007);
 - 第 18-2 部分:空白详细规范 非固体电解质片式铝固定电容器 评定水平 E(GB/T 17208—1998/IEC 60384-18-2:1993);
 - 第 19 部分:分规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-19:2006);
 - 第 19-1 部分:空白详细规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(IEC 60384-19-1:2006);
 - 第 21 部分:分规范 表面安装 1 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21041—2007/IEC 60384-21:2004);
 - 第 21-1 部分:空白详细规范 表面安装 1 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 21038—2007/IEC 60384-21-1:2004);
 - 第 22 部分:分规范 表面安装 2 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21042—2007/IEC 60384-22:2004);
 - 第 22-1 部分:空白详细规范 表面安装 2 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 21040—2007/IEC 60384-22-1:2004)。

本部分为《电子设备用固定电容器》系列国家标准第 16-1 部分。

本部分按 GB/T 1.1—2009 和 GB/T 20000.2—2009 给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用 IEC 60384-16-1:2005《电子设备用固定电容器 第 16-1 部分:空白详细规范,金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ》。

本部分做了下列编辑性修改:

- 删除了 IEC 前言;
- 删除了第 1 页“序言”两字;
- 本标准一词改为本部分。

本部分代替 GB/T 10191—1988。本部分与 GB/T 10191—1988 相比,主要变化如下:

- 增加了金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器评定水平 EZ;

——试验和测量程序中增加了:A0组试验、标志耐溶剂试验和元件耐溶剂试验等内容;

——A1试验分组的检查水平“S-4”及A2试验分组的检查水平“Ⅱ”均调整为“S-3”。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会(SAC/TC 165)归口。

本部分起草单位:鹤壁市华中科技电子有限责任公司。

本部分主要起草人:樊金河、宁小波、张素霞、李素兰、杜宝玉。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 10191—1988。

电子设备用固定电容器

第 16-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器

评定水平 E 和 EZ

空白详细规范

空白详细规范是分规范的一种补充性文件,它包括了详细规范的格式、编排和最低限度的内容要求。不遵守这些要求的详细规范,认为是不符合电子元件质量评定体系要求的规范。

制定详细规范时应考虑分规范 IEC 60384-16 中 1.4 的内容。

首页方括号中数字标注的位置上应填写下列相应内容:

详细规范的识别

- [1] 授权起草本详细规范的组织:IEC 或国家标准机构。
- [2] IEC 或国家标准的详细规范编号、发布日期以及国家标准体系所要求的任何更多的内容。
- [3] IEC 或国家标准的总规范编号及其版本号。
- [4] IEC 或国家标准的空白详细规范编号。

电容器的识别

- [5] 该型号电容器的简述。
- [6] 典型结构的简述(适用时)。

注:当电容器不是设计用于印制电路板时,在详细规范的这个位置上应该明确地加以说明。

- [7] 简述对于互换性有重要影响的主要尺寸的外形图,和(或)引用关于外形方面的国家文件或国际文件。也可以在详细规范的附录中给出此图。

- [8] 用途或所涉及的应用类别和/或评定水平。

注:详细规范中采用的一个评定水平或若干个评定水平,应从分规范 IEC 60384-163.5.4 中选取,这意味着如果试验的分组不变,一个空白详细规范可提供若干个评定水平的组合。

- [9] 重要特性的参考数据,以便在各种类型的电容器之间进行比较。

[1]	GB [2]
电子元器件质量评定按: <div style="text-align: center;">[3]</div>	IEC 60384-16-1 QC 301201 <div style="text-align: right;">[4]</div>
外形图(见表 1) (第...角视图) <div style="text-align: center;">[7]</div> (在给定的尺寸范围内,允许有其他形状)	金属化聚丙烯膜介质 直流固定电容器 <div style="text-align: right;">[5]</div> <div style="text-align: right;">[6]</div> 评定水平:E 和 EZ 性能等级:… 稳定性等级:… <div style="text-align: right;">[8]</div>
注:[1]~[9]见上文。	

按本详细规范鉴定合格的元件的有效数据在鉴定合格产品一览表中给出。

[9]